



Be- und Entladen von
Lasersystemen

baumann
WAFERHANDLING LASER
GENERATION 3

baumann

WAFERHANDLING LASER GENERATION 3

Um die Effizienz der Solarzellen zu steigern werden Laser zur Materialverarbeitung eingesetzt. Die Wafer werden, bei hohem Durchsatz, einzeln und mit maximaler Präzision dem Laser zugeführt. **baumann Waferhandling Laser** automatisiert diesen Be- und Entladeprozess.

Die Wafer werden mit ein-/mehrspurigen Bändern durch die Anlage transportiert. Speziell entwickelte Vereinzeln- und Transporttechniken garantieren ein stressfreies Waferhandling bei minimaler Bruchrate.

baumann Waferhandling Laser wurde unter Verwendung von Standardkomponenten entwickelt, um hohe Zuverlässigkeit, Flexibilität und kurze Lieferzeiten zu gewährleisten.

Hauptmerkmale

Durchsatz	bis zu 3.600 W/h
Bruchrate	≤ 0,1 %
Technische Verfügbarkeit	≥ 98 %

Technische Daten

Orientierung der Anlage	rechts- oder linksseitige Orientierung
Waferzufuhr/-abgabe	<ul style="list-style-type: none"> • BAC [baumann Automationscarrier] • LSC • TRC • [weitere Carriertypen auf Anfrage]
Schnittstelle	<ul style="list-style-type: none"> • Wafertransportband • [weitere Schnittstellen auf Anfrage]
Wafergröße	<ul style="list-style-type: none"> • 156 x 156 mm • 125 x 125 mm
Waferdicke	150 – 330 µm
Abmessungen	Beladen: 1.850 mm / 2.450 mm / 2.040 mm [l x b x h] Entladen: 1.850 mm / 2.450 mm / 2.040 mm [l x b x h]
Optionen	<ul style="list-style-type: none"> • Fernwartung • Virtuelle Waferverfolgung • MES Anbindung [SECS/ GEM]